

V I S U A L I Z E T H E F U T U R E



2012年3月期 決算説明会

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

2012年5月18日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保障するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

- 1 2012年3月期 決算について
- 2 2013年3月期 通期見通しについて
- 3 DMPを取り巻く環境について
- 4 新製品について
- 5 DMPの今後の戦略について



1 2012年3月期 決算について

- ライセンスの新規契約の状況 -

- 年度前半に米国大手半導体メーカーをはじめとする複数の顧客との間で締結
- 当社のグラフィックスIPを搭載した富士通セミコンダクターのSoC (System on Chip) 評価キットの出荷を開始

- グローバル戦略の状況 -

- 米国シリコンバレーに「DMP USA」を設立し、積極的な営業活動を開始
- 世界最大の半導体ファウンダリーである台湾のTSMC社や米国の大手FPGA (Field Programmable Gate Array) ベンダーであるXilinx社とのアライアンスを締結

- ランニングロイヤリティの状況 -

- 任天堂「ニンテンドー3DS」のライセンス収入が引き続き堅調に推移
- オリンパス デジタルカメラ「PEN」シリーズのロイヤリティ収入を計上

2012年3月期 決算概況

VISUALIZE THE FUTURE



(百万円)

項目	12/03期 通期実績	前期実績	前期比	修正予想	達成率	期初予想	修正予想	増減
売上高	1,044	1,013	30	1,050	99.5%	1,324	1,050	△274
営業利益	319	315	4	320	99.9%	423	320	△103
経常利益	302	314	△11	310	97.7%	401	310	△91
当期純利益	188	491	△303	185	101.8%	432	185	△247

- 平成23年6月23日に開示した平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の業績予想を修正しております。

2012年3月期 通期

(百万円)

項目	計画 (A)	実績 (B)	増減 (B-A)		
				前期実績	前期比 (%)
LSI製品事業	8	8	0	68	△87.9%
IPコアライセンス事業	859	853	△6	911	△6.4%
その他の事業*	183	183	0	33	444.3%
売上高	1,050	1,044	△6	1,013	3.0%

*その他の事業にIPコアライセンスに係る受託開発を含んでおります。

業績予想の修正要因について

VISUALIZE THE FUTURE



■ 2011年10月12日修正

売上高・利益の上方修正 ランニングロイヤリティおよび受託開発案件の順調な進捗

■ 2012年2月8日修正

- 売上高 -

LSI製品事業

- ・既存LSI製品 Δ 58百万円・・・業界のリユース（部品の再利用）の影響
- ・次世代LSI受託開発 Δ 100百万円・・・翌期以降にずれ込む

IPコアライセンス事業

- ・新規IPコアライセンス Δ 104百万円・・・顧客である国内コンシューマーメーカーの経営環境の悪化による新規開発案件の遅延

- 営業利益・経常利益 -

LSI製品事業

- ・既存LSI製品 Δ 11百万円
- ・次世代LSI 0百万円・・・売上相当の原価を見込んでいたため利益影響なし

IPコアライセンス事業

- ・新規IPコアライセンス Δ 104百万円

- 当期純利益 -

繰延税金資産の取崩110百万円

2012年3月期 決算概況

VISUALIZE THE FUTURE



2012年3月期末財政状況

(百万円)

	当事業年度		前事業年度		増減	備考
	金額①	構成比	金額②	構成比	①-②	
現金預金	2,316	83.6	926	55.8	1,398	上場に伴う一般募集・第三者割当等による増加
売掛資産	293	10.6	479	28.9	△185	
繰延税金資産	70	2.6	184	11.1	△113	
その他流動資産	27	1.0	22	1.4	4	税制改正・受注見通しを踏まえた見直しによる減少
固定資産	61	2.2	47	2.8	14	
資産合計	2,769	100.0	1,659	100.0	1,109	
流動負債	93	3.4	117	7.1	△23	
固定負債	8	0.3	8	0.5	0	
負債合計	102	3.7	125	7.6	△23	
資本金	822	29.7	350	21.1	472	上場に伴う一般募集・第三者割当等による増加
資本剰余金	841	30.4	369	22.2	472	
利益剰余金	1,002	36.2	814	49.1	188	
純資産合計	2,666	96.3	1,533	92.4	1,133	
負債純資産合計	2,769	100.0	1,659	100.0	1,109	



2 2013年3月期 通期見通しについて

2013年3月期 業績予想について

VISUALIZE THE FUTURE



2013年3月期 決算の見通し

(百万円)

項目	13/03期 通期予想	12/03期 通期実績	増減	前年同期比 (%)
売上高	1,100	1,044	56	5.3
営業利益	230	319	△89	△28.0
経常利益	220	302	△82	△27.3
当期純利益	220	188	32	16.8

2013年3月期 事業別の売上高

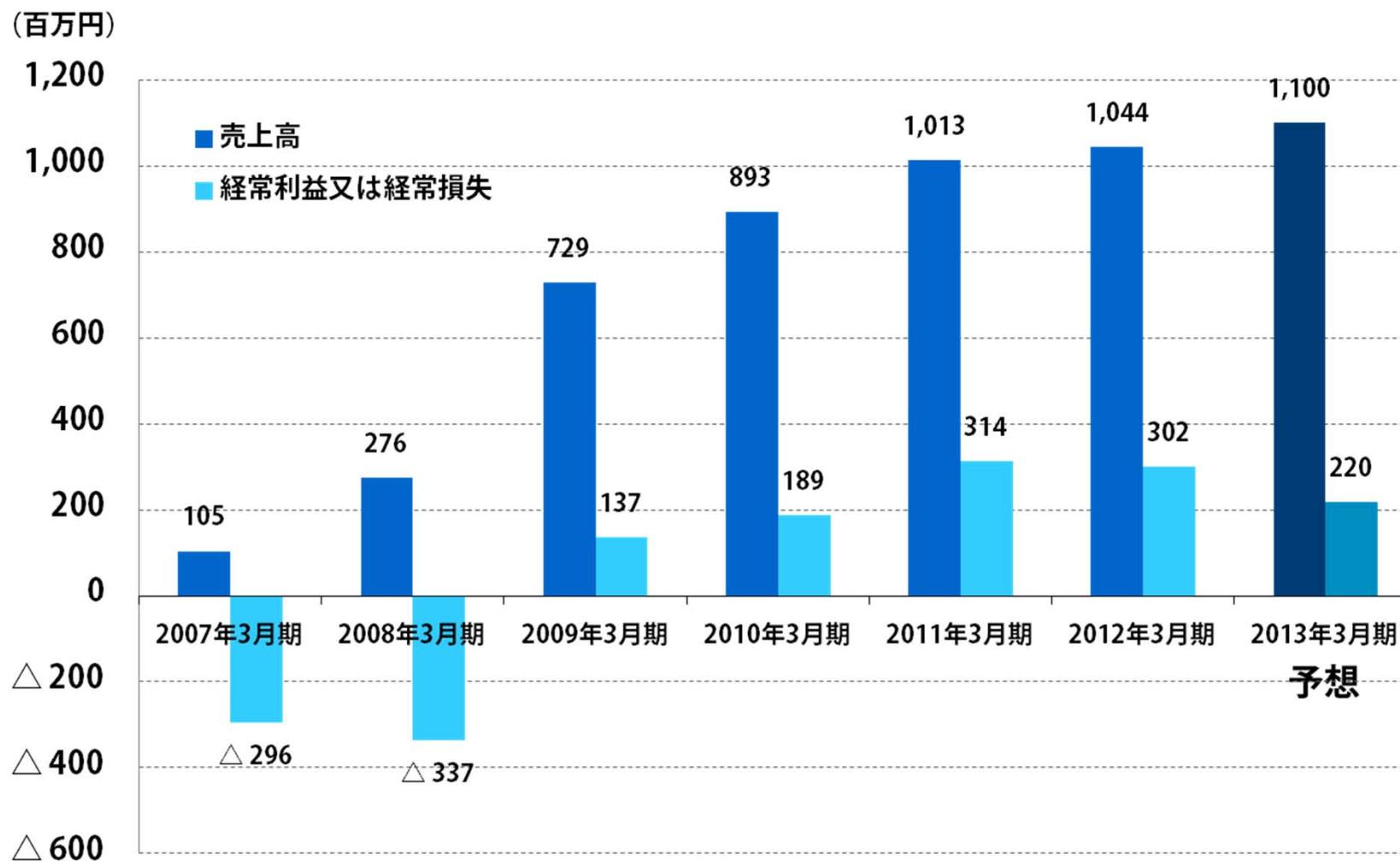
(百万円)

項目	前期実績 (A)	計画 (B)	増減 (B-A)	前期比 (%)
LSI製品事業	8	100	92	1,150.0
IPコアライセンス事業	853	996	143	16.8
その他の事業*	183	4	△179	△97.8
売上高	1,044	1,100	56	5.3

*その他の事業にIPコアライセンスに係る受託開発を含んでおります。

業績の推移

VISUALIZE THE FUTURE



- 売上高 -

LSI製品事業

- ・次世代LSI開発受託による増加

IPコアライセンス事業

- ・ランニングロイヤリティ

新規2案件が量産開始予定

既存顧客は数量増加も単価低下のため減額見込み

- ・新規IPコアライセンス受注

IP製品ポートフォリオの充実（最適なソリューションの提供）

国内の受注活動に加え、北米・アジアにおける契約獲得に注力

- 利益（コスト増加の要因） -

事業拡大のための成長投資と国内外の売上拡大に向けた体制の強化

- ・開発・営業体制の強化（人件費の増加） 50百万円
- ・次世代LSI開発費 50百万円
- ・海外拠点費用の増加 30百万円

1. 目的

- ❖ 資本効率の向上
- ❖ 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施
- ❖ 株主への利益還元

2. 取得に係る事項の内容

- (1) 対象株式の種類 普通株式
- (2) 株式の総数 10万株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.1%)
- (3) 取得価額の総額 1億8千万円（上限）
- (4) 期間 平成24年5月10日から平成24年7月31日まで



3 DMPを取り巻く環境について

- 国内 -

- 2011年度は円高、災害等の影響でCEメーカー中心に開発案件減少、先送りが目立つ
- 国内半導体ベンダーのスマートフォン向けシステムLSI参入が遅れる
- 2012年度はCEメーカー、組み込み機器メーカーなどの開発意欲が盛り返す

- 海外 -

- 米国：スマートフォン、タブレット向けシステムLSI開発が活発
- 中国・台湾：ローエンドスマートフォンやスマートTV向けシステムLSI開発が活発
- 韓国：国内電機セットメーカーの成長で内需を中心にLSI開発が旺盛

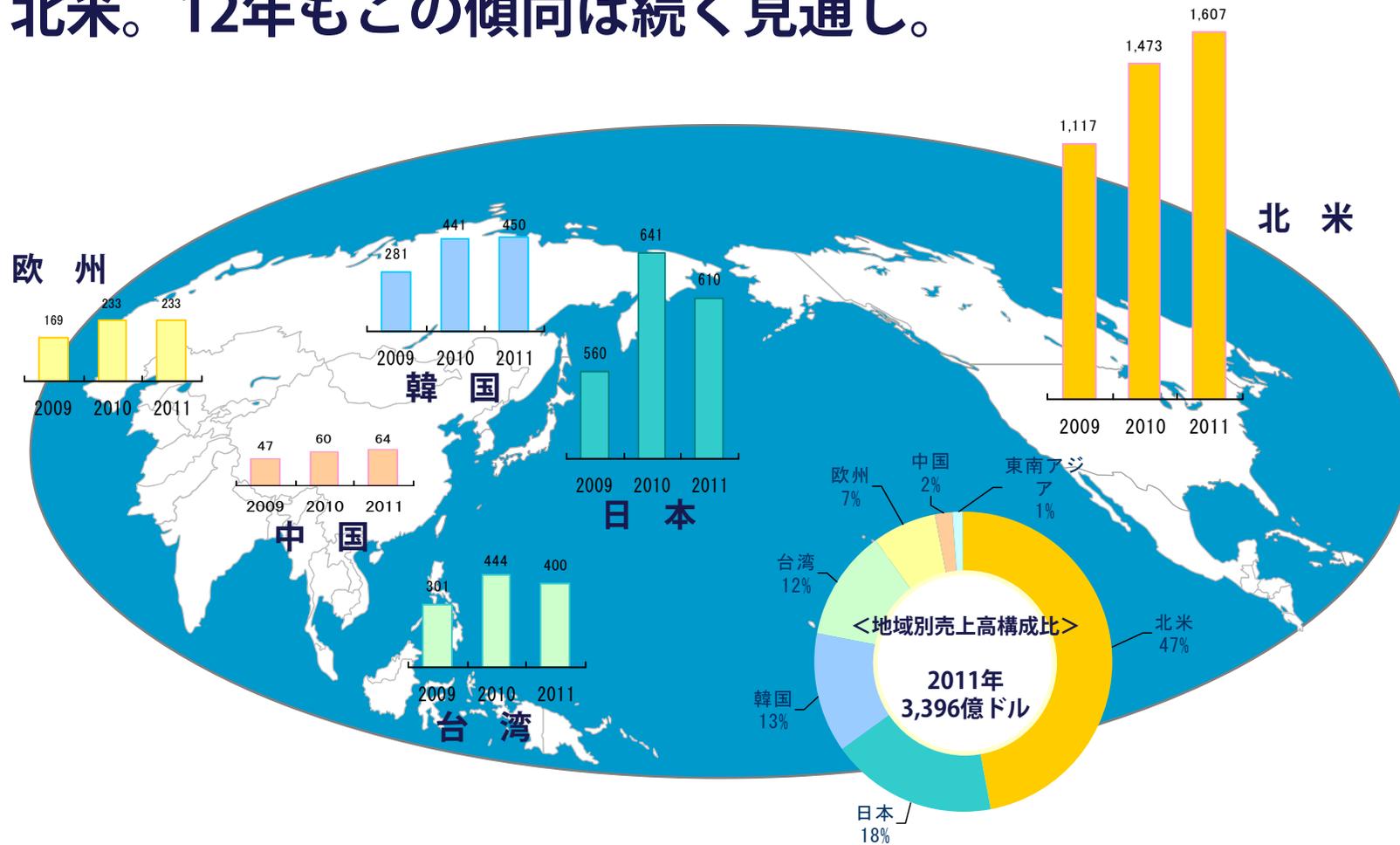
2011年 世界半導体市場の推移

VISUALIZE THE FUTURE

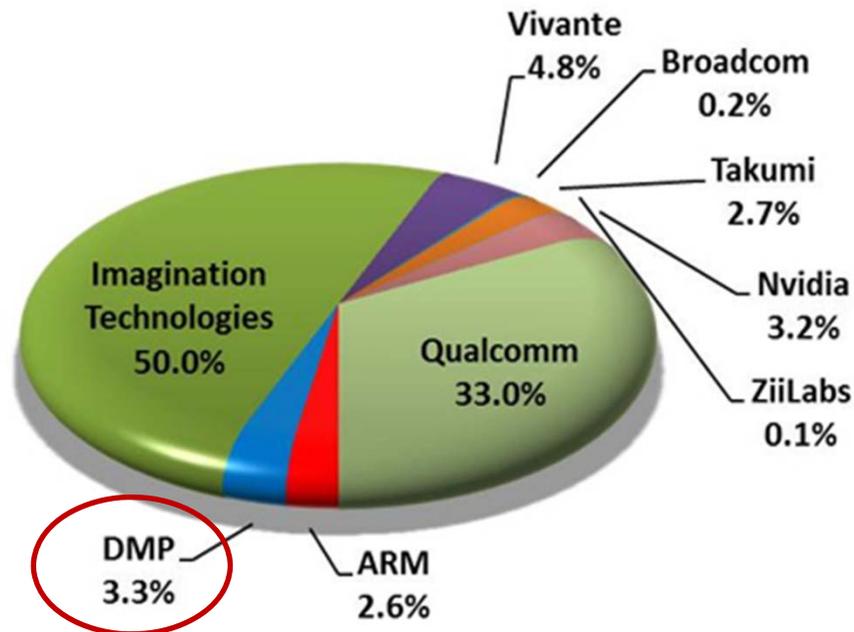


国・地域別で最も高い成長を示したのは
北米。12年もこの傾向は続く見通し。

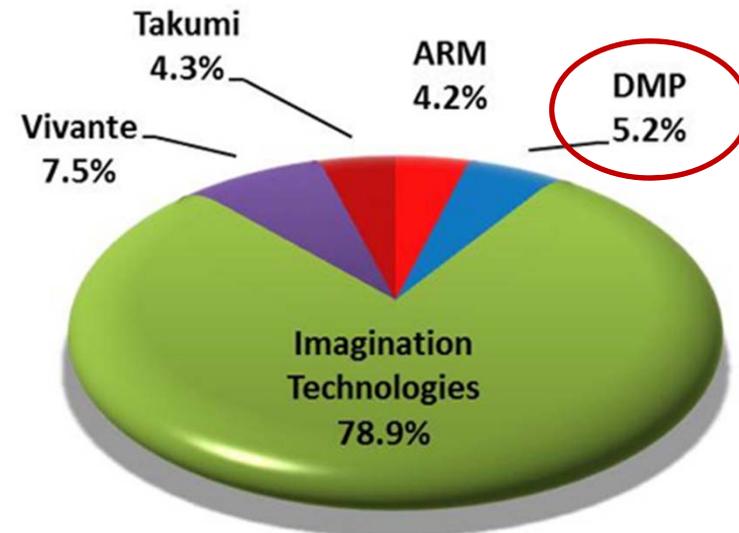
(単位：億ドル)



グラフィックスプロセッサ（GPU）の
出荷数は世界で増加の一途をたどっており、
DMPも健闘している。

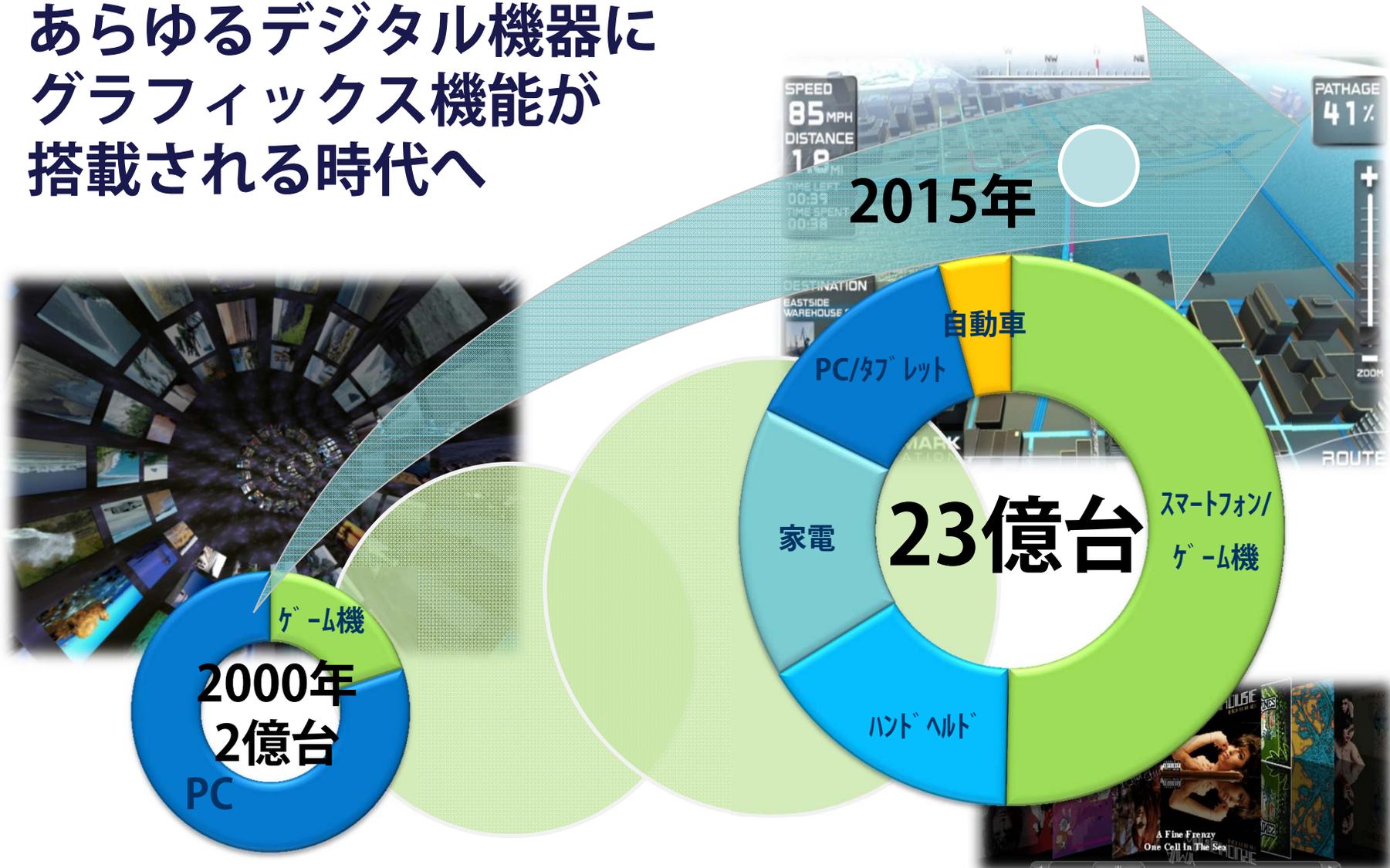


モバイル向けGPUコアのベンダー別市場シェア
出典：Jon Peddie Research Mar. 2012



IPコア専門ベンダーのモバイル向けGPU市場シェア
出典：Jon Peddie Research Mar. 2012

あらゆるデジタル機器に グラフィックス機能が 搭載される時代へ



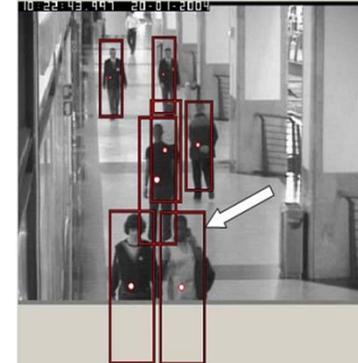
グラフィックス・プロセッサの利用が 今後画像演算処理などコンピューティング分野にも拡大



顔認識



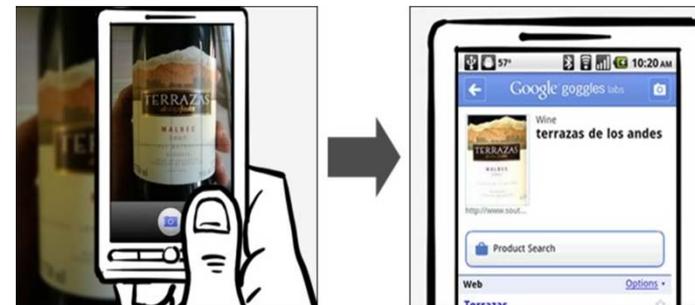
自動車安全システム



セキュリティー



ジェスチャー認識



ピクチャー検索

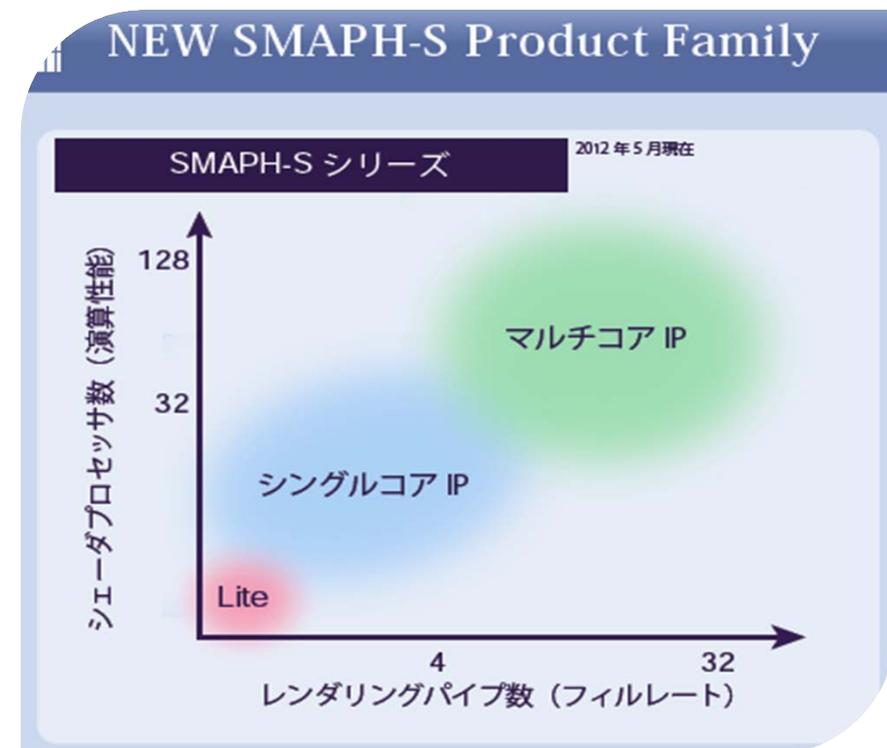


4 新製品の発表

マルチコア構成ハイエンドIPコア SMAPH-S新シリーズ

[特徴]

- 1コアあたり最大32プロセッサー搭載可能 (業界最大)
- クアッドコア (4コア) に対応
- 最大128プロセッサー構成可能 (業界最大)
- 世界最小のOpenGL ES 2.0対応IPコアSMAPH-S Lite



※2012年5月現在

- ❖ **クアッドコア**対応でハイエンドのスマートフォン、タブレットの要求に応える事が可能に
- ❖ **世界最小**のOpenGL ES 2.0対応SMAPH-S Liteにより、フィーチャーフォン市場の置き換えとして、今後成長が期待されるローエンドスマートフォン市場の要求に対応可能に
- ❖ 画像処理等コンピューティング市場向けにOpenCL規格にも適合予定

数値で見るDMPの競合優位性

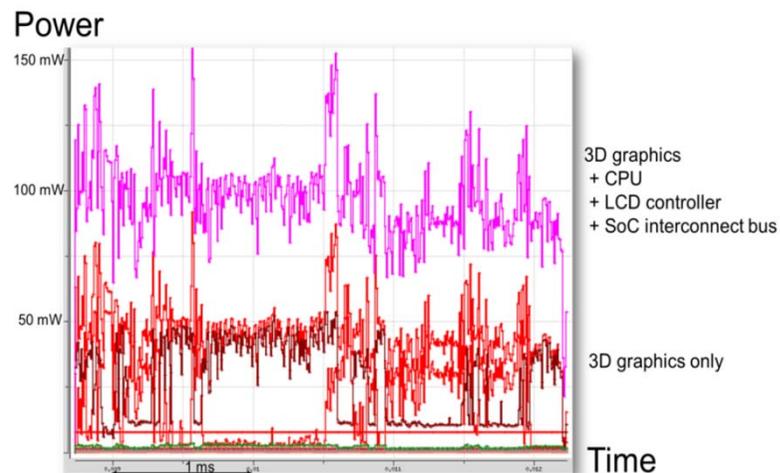
VISUALIZE THE FUTURE



GLBenchmark 2.1 Egypt Offscreen 720p

DMP SMAPH-S/MC2	144.6 FPS
DMP SMAPH-S	72.3 FPS
IMG SGX543MP4	140.9 FPS
NVIDIA Tegra 3	72.0 FPS
QC Adreno 225	57.5 FPS
ARM MALI400MP	52.9 FPS
Vivante GC1000	31.2 FPS

DMPは圧倒的に消費電力が少ない

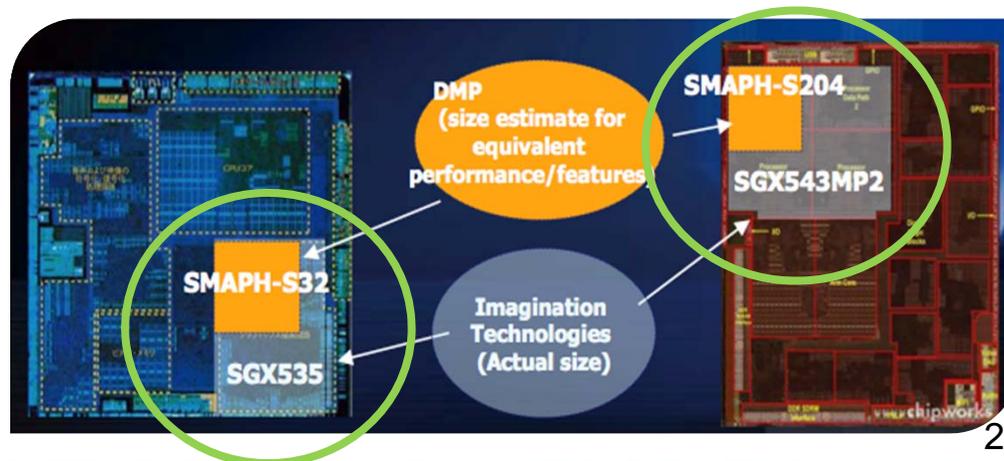


同じ性能でも、DMPはサイズが2~4倍小さい

Source: www.glbenchmark.com/

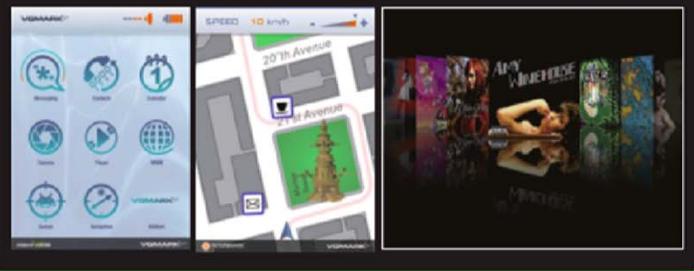
GLBenchmark

GLBenchmarkとはグラフィック性能を図るベンチマークサイト。



OpenGL ES 2.0対応2D/3Dハイブリッド IPコアSMAPH-H2

プリンター、デジタルカメラ等に最適なコア

2Dベクターグラフィックス OpenVG 1.1 対応	3Dグラフィックス OpenGL ES 2.0 対応
高解像度でも画像劣化しないスケーラブルなフォント描画を含むユーザーインターフェースを実現。Adobe Flashに対応。	視点の自由なコントロールや奥行を利用した圧倒的なビジュアル演出を含むユーザーインターフェースを実現。各社3D UI制作支援ツールに対応。
<p style="text-align: center;">SMAPH®-F SMAPH®-H2 SMAPH®-S</p>	
	

SMAPHの製品ラインを大幅に拡充

VISUALIZE THE FUTURE



業界で最も競争力のある 製品ラインアップを実現

	3D グラフィックス機能		2D ベクタ グラフィックス 機能	DMP 拡張機能
	OpenGL ES 1.1	OpenGL ES 2.0	OpenVG 1.1	MAESTRO
SMAPH®-S プログラマブルシェーダコア	オプション	標準装備	オプション	
NEW SMAPH-S Lite 世界最小OpenGL ES 2.0対応コア	オプション	標準装備		
NEW SMAPH-H2 3D/VGハイブリッドコア	標準装備	標準装備	標準装備	
SMAPH-F VGコア			標準装備	
PICA® 200 フォトリアリスティック3Dコア	標準装備			標準装備
PICA200 Lite 低コスト3Dコア	標準装備			

● 標準装備 ● オプション



5 DMPの今後の戦略について

成長する地域に開発・販売体制を確立

日本

- ・コア技術の開発
- ・国内顧客への販売・サポート
- ・海外子会社・パートナーのサポート
- ・サードパーティーとのアライアンス

台湾/中国

- ・パートナーとの開発および販売提携

グローバル

- 米国シリコンバレーに拠点を設立
- ・グローバルな開発体制
- ・海外顧客の獲得
- ・海外有力企業との関係性の強化

世界の有力半導体メーカーとの
アライアンスを積極的に推進

新規ライセンスビジネスの獲得



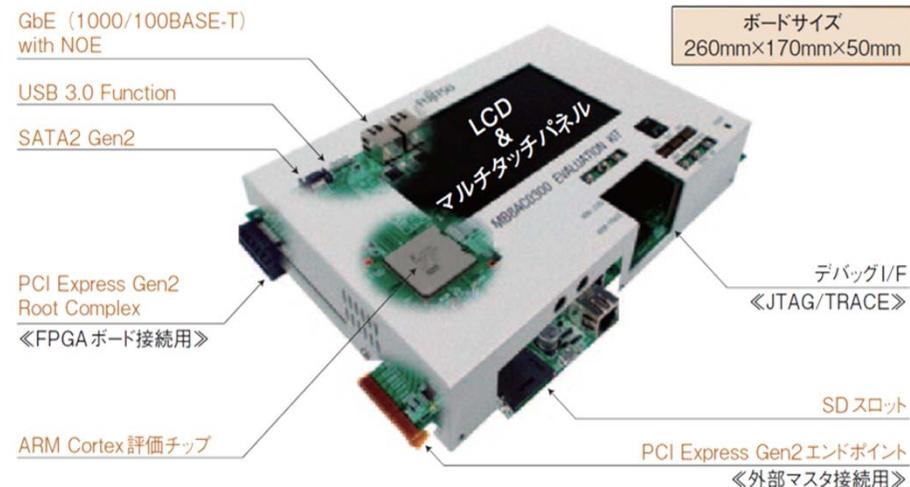
海外市場の開拓



DMPグラフィックスコアを**標準搭載**した
富士通セミコンダクター社のARMプラットフォームの
出荷が開始。今後の新規ライセンスへ貢献。

DMP SMAPH/PICA

標準搭載

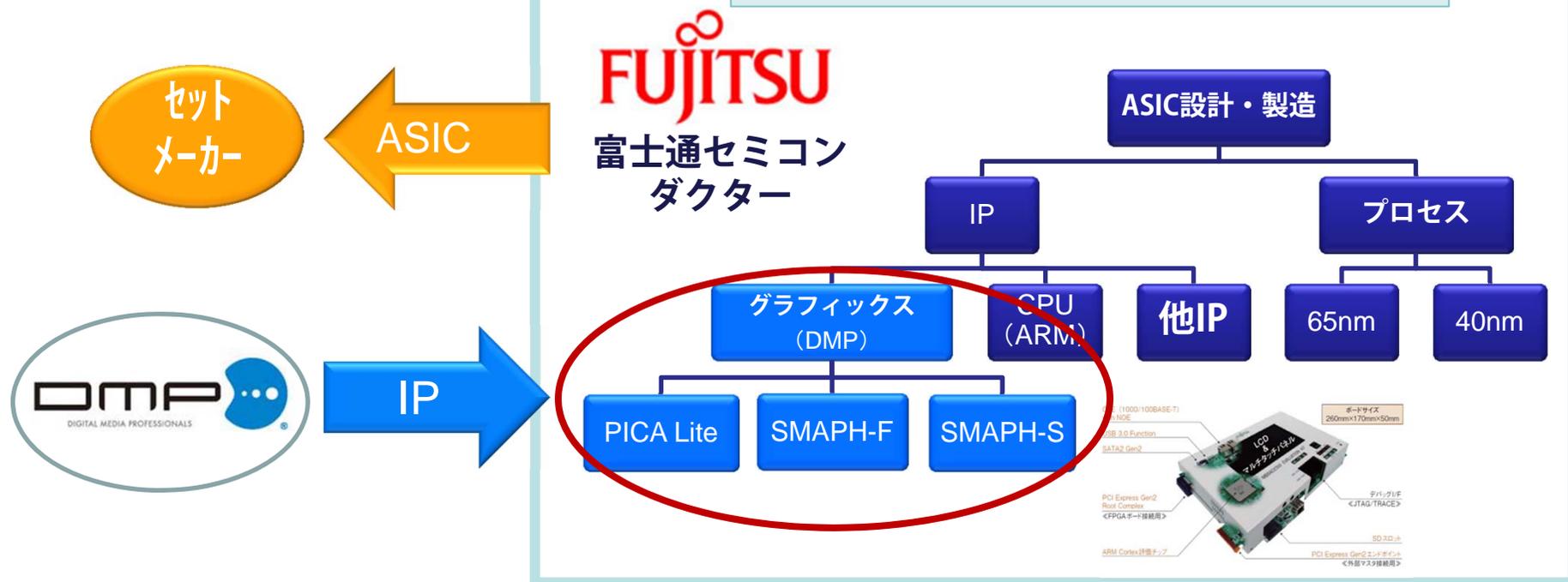


富士通セミコンダクター株式会社は、富士通グループの半導体事業会社としてビジネスを展開しており、LSI 製品・サービスをグローバルに提供しています。

組み込み向けASIC 世界トップシェア

分野：カメラ、自動車、通信、プリンター/複合機、産業機器、その他

富士通ASIC開発プラットフォーム



DMP IPが標準提供され、実製品への採用が容易に。

-  TSMCがDMPグラフィックスIPを認証済みサポートコアとして推奨。日本のIPベンダーでは**DMPのみ**が認証される。
-  米国大手半導体メーカー(IDM)がDMPグラフィックス搭載のLSIを**アジア組み込み市場に展開中**。
-  Xilinxのパートナープログラムを通じてDMPコアを提供中。



東京エレクトロンデバイスが提供する
DMP/Xilinx FPGA開発ボード

シリコンバレーには、世界中の有力なITベンダーが集結しており、DMPでは**世界への布石**の場と捉えています。



シリコンバレー子会社の目的

- グローバルな開発/営業体制
- グローバル企業との交渉窓口の場
- 海外企業との関係性の強化
- 市場調査

受注済み案件：現在 5 顧客で新規SoC開発中

顧客A	2013/3月期
顧客B	2013/3月期
顧客C	2014/3月期
顧客D	2014/3月期
顧客E	2015/3月期

今期は国内の他、海外顧客の開拓にも注力

米国： 12年1月よりDMP USA稼働

AP: 12年6月より本格的な営業活動開始予定

12ヶ月-

SmartPhone

Smart TV

SmartPhone

Smart Phone/Tablet

Smart TV

Smart Phone

Smart TV/STB

SmartPhone

0-12ヶ月

Tablet

Smart TV

Industrial

海外リード顧客
(米国/AP)





日本から世界へ

Visualize the Future

無限のイノベーションの可能性を持つグラフィックスの世界で、常に独創的なアイデアで製品開発を行い世界のリーダーを目指します。